

# 深圳市龙图光罩股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2025-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研      <input type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访              <input type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会            <input type="checkbox"/>路演活动  <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（<u>请文字说明其他活动内容</u>）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>博时基金、人保资产、招商证券、平安证券、长城证券、博云创投</p>
<p>时间</p>	<p>2025年2月25日星期二</p>
<p>地点</p>	<p>深圳市龙图光罩股份有限公司</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>1、总经理助理：邓少华 2、证券事务代表：李建东</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>一、公司基本情况</b></p> <p>深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。</p> <p>公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺节点从1<math>\mu</math>m逐步提升至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。</p> <p>公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入，逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套，深耕特色工艺，突破高端制程，立志成为国际一流的半导体光罩企业。</p> <p><b>二、投资者互动交流</b></p> <p><b>1、公司珠海工厂募投项目当前进度如何？</b></p> <p>回复：目前，珠海工厂的募投项目正处于推进过程</p>

中，尚未正式投产并释放产能，但公司已初步完成了第三代光罩产品的工艺调试及样品试制工作。产能释放的具体进度将取决于客户工艺匹配的难易程度、送样认证的通过速度以及客户开始小批量采购的时间周期，公司正积极与客户沟通协作，推动募投项目尽快达产见效。

**2、公司深圳工厂和珠海工厂产能情况？珠海工厂的产品的应用领域？**

回复：深圳工厂目前产能利用率稳定在较高水平。由于掩模版产品系高度定制化，需根据客户特定需求生产，因此很难达到理想的满产状态，但现有的产能利用率能够有效保障客户订单的按时交付，同时兼顾产品质量与生产效率的平衡。珠海工厂的年达产产能规划为 1.8 万片，预计达产产值为 5.4 亿元，应用于射频芯片、MCU 芯片、DSP 芯片、CIS 芯片等领域。

**3、公司目前主要的客户群体及公司拓展新客户的策略？**

回复：公司的客户涵盖晶圆厂、芯片设计公司、研究所和高等院校等。因为掩模版具备“模具”的属性，对下游客户的良率和产品质量至关重要，所以公司拓展新客户的核心首先在于产品的制程能力、工艺匹配程度和质量，价格虽是重要考量因素之一，但上述技术水平和质量水平更重要。同时，公司保证掩模版的按时交付以及稳定可靠供货，也是赢得客户合作的关键优势。

**4、公司如何看待未来掩模版市场的竞争？**

回复：展望未来掩模版市场的竞争格局，公司认为主要的竞争仍将集中在与国外掩模版厂商抢占市场份额上。在半导体掩模版市场中，国外厂商长期占据重要份额。此外，公司认为未来竞争的核心在于工艺匹配程度，即能否更好地满足客户在不同制程节点和应用场景下的特定需求。公司将继续加大研发投入，提升技术水平，优化产品性能，以增强在市场中的竞争力。

**5、公司的研发团队构成情况？**

回复：公司研发团队以内部培养为主，通过系统的

	<p>培训体系与完善的晋升机制，为员工提供广阔的发展空间。同时，公司也积极从先进同行或大型晶圆厂引进了专业人才，有力提升了公司的工艺水平，为解决各类技术难题提供了支持。</p> <p><b>6、公司产品目前主要的应用领域是什么？石英掩模版和苏打掩模版有什么区别？</b></p> <p>回复：公司掩模版目前最主要的领域是功率半导体。石英掩模版以高纯石英玻璃为基材，具有高透过率、高平坦度、低膨胀系数等优点，成本较高，通常应用于高精度掩模版产品，主要用于对精度要求较高的功率半导体、MEMS、先进 IC 封装等领域。苏打掩模版使用苏打玻璃作为基板材料，热膨胀率相对高于石英玻璃，平整度和耐磨性相对弱于石英玻璃，成本相对较低，通常应用于中低精度掩模版产品，主要用于对精度要求较低的中低端半导体制造、半导体封装、光学器件、触控屏和电路板制造等领域。</p> <p><b>7、公司预计实现国产替代化的时间周期？</b></p> <p>回复：公司实现国产替代化的时间周期受多种复杂因素交互影响，难以明确预估。国内产业链内部的协同配合对于国产替代化进程影响重大。在产业链上游，原材料供应商的发展水平至关重要。若国内原材料供应商能加快技术创新，提高产品质量和供应稳定性，比如在平坦度、稳定性等关键指标上达到公司生产要求，将为国产替代化奠定基础。公司与上下游企业之间的沟通和磨合也不可或缺，各方需要共同解决诸如产品标准统一、工艺需求匹配等问题，但这些环节都需要一定时间来发展和完善。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 25 日星期二